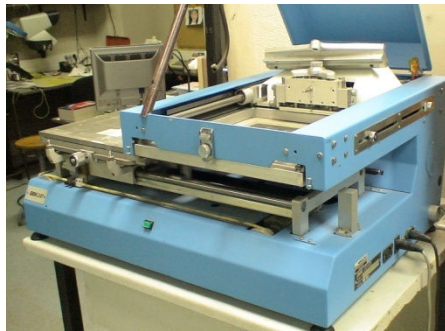


Le Centre d'Enseignement et de Développement pour le Montage en Surface **CEDMS**

quelques-uns de nos équipements

Four à «chaleur tournante »
(étude des profils thermiques)



Sérigraphieur
Dépose de la crème à
braser



**Mesure d'épaisseur sans
contact (résolution 1 µm)**



**Postes manuels d'initiation au
placement des CMS**



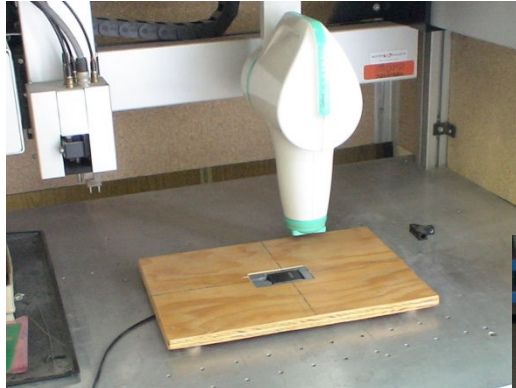
Pose et réparation des BGA et exposed PAD

**Et aussi: Machines de placement CMS,
fours à IR, brasage phase vapeur,
graveur d'écrans et pochoirs, débrassage
des CMS, Vague, CAO**



Rapide coup d'œil sur quelques-uns de nos équipements

contrôles et tests



Rayons X (Voïds,Courts circuits)

Tests d'arrachements
(validation des profils
thermiques et compatibilité)



Visualisation tangentielle (BGA)



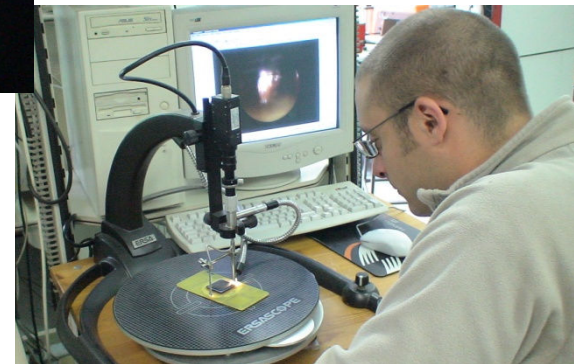
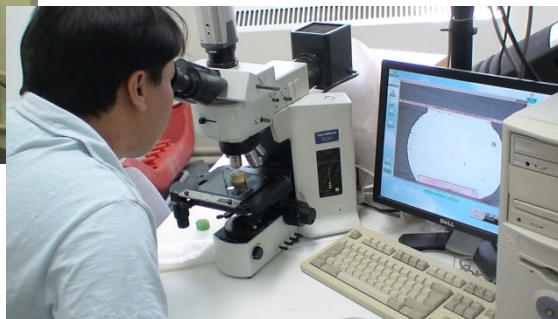
Notre Technicienne
(pour du travail super fin!)



Polissage

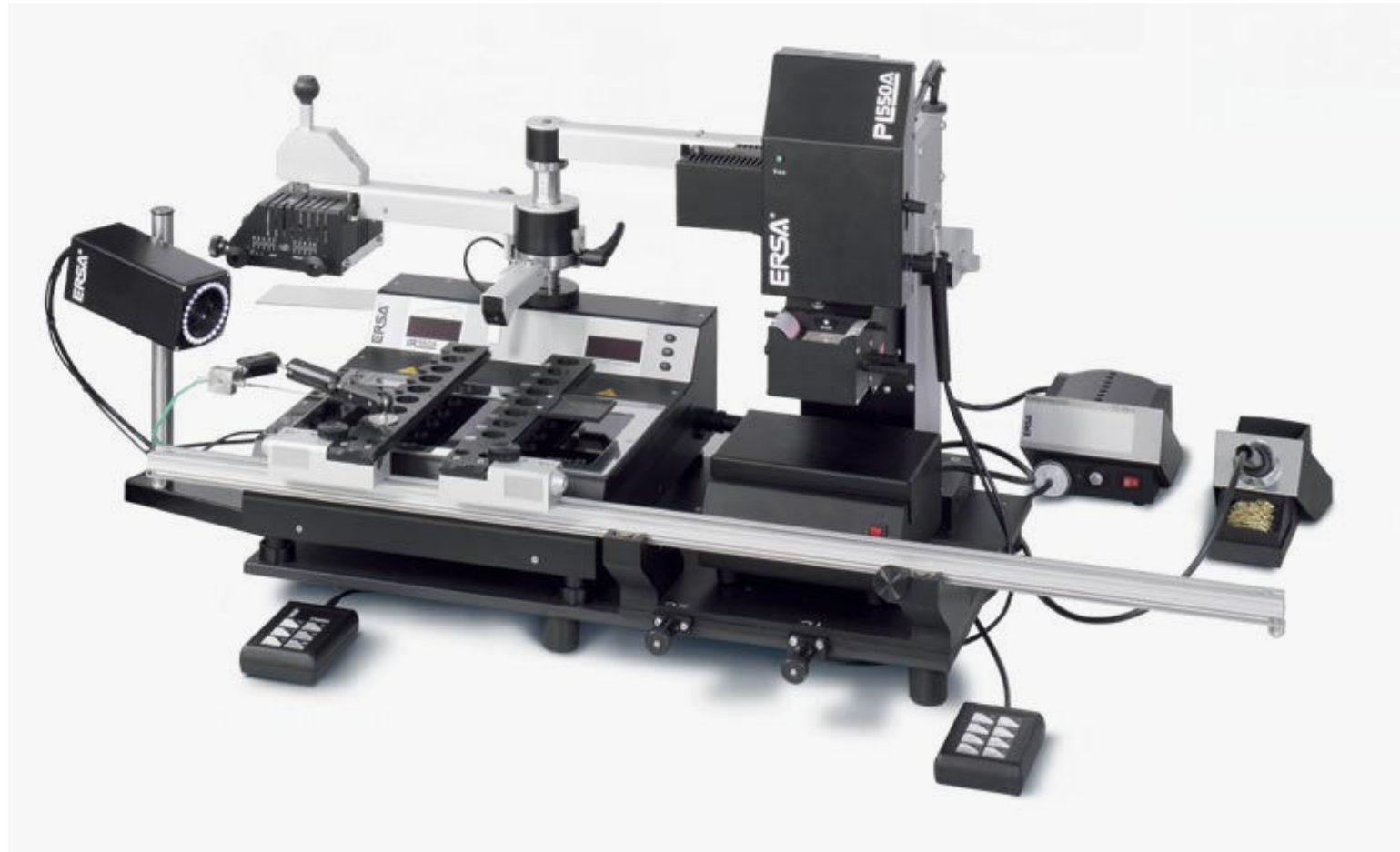
Coupes métallographiques

Microscopie à réflexion jusqu'à G=1000



**ET:Chocs thermiques, tests SIR,
Contaminométrie, Fluorescence X...**

Les nouveaux équipements en 2010



Machine de Rework BGA



Les nouveaux équipements en 2010



Figure 1. The BGA package has not been placed into the paste deposit.



Figure 6. Lead-free joint on a SOIC after reflow soldering in a convection process.

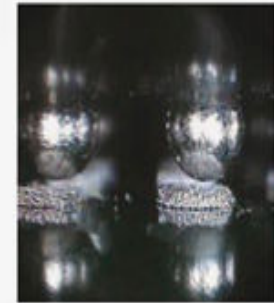


Figure 9. Another BGA package that has not been placed into the paste deposit.

Ersascope II



Les nouveaux équipements en 2010



Four de refusion sous vide UNITEMP (acheté par le G2ELab)

⇒ **Packaging haute température des puces de puissance,**

⇒ **Process flip chip**